

製品仕様書 PRODUCT SPECIFICATION	No.	IS-11007-001	頁/page	1/6
	来歴/ REV.			4
標 題 : 11007S シリーズ 0.4 mmピッチ ボードトゥボードコネクタ	制定年月日 / ISSUE DATE		2017-03-06	
SUBJECT : SERIES 11007S 0.4 mm pitch board to board connector	改訂年月日 / REVISED DATE		2018-07-05	

1. 適用範囲 / Scope

本仕様書は、イリソ電子工業株式会社製 11007S/10126B シリーズ 0.4mmピッチ ボードトゥボードコネクタに関する仕様及び性能上の必要事項について規定する。

This product specification is applied for IRISO ELECTRONICS CO.,LTD. series 11007S/10126B 0.4 mm pitch board to board connector

適合ソケット / Applied socket : IMSA-11007S-\*\*A-GFN4

適合プラグ / Applied plug : IMSA-10126B-\*\*A/B/C-GFN4 △△

2. 形状、寸法及び材質 / Configurations dimensions and materials

構造、寸法、主要部品の材質、表面処理等は添付図面による。

See the product drawing attached.

3. 定格 / Rating

No.	項目 / Items	方法 / method	条件 / conditions	規格 / specifications
3-1	使用温度範囲/ Operating temperature limit	IEC : 603-1	-40~+125℃ △ 通電による温度上昇を含む Including temperature rise due to energization	
3-2	定格電圧 /Voltage rating	IEC : 603-1	50V (AC,DC)	
3-3	定格電流 /Amperage rating	IEC : 603-1	△ 0.4 A	

4. 試験環境 / Environmental condition

No.	項目 / Items	方法 / method	条件 / conditions	規格 / specifications
4-1	環境条件/ Environmental qualification	JIS : C60068-1-5-3 (IEC : 60068-1)	常温/Ambient temperature : 15~35℃ 常湿/Ambient humidity : 25~85%RH	

5. 電気的特性/Electrical performances

No.	項目 / Items	方法 / method	条件 / conditions	規格 / specifications
5-1	接触抵抗 / Contact resistance	IEC : 60512	短絡電流 / Current : 1mA 最大開放電圧 / Voltage : 20mV 周波数 / Frequency : 1 k Hz	初期値 / Initial : 100 mΩ MAX 各試験後 / After each test : 120 mΩ MAX
5-2	耐電圧 / Dielectric Withstanding Voltage	IEC : 60512-4-1	AC100V , 60±5sec	絶縁破壊、クッシュアウトなきこと。また、許容電流 2mA を満足する事。 Should not have Dielectric breakdown, flashover. And thing to satisfy 2mA in the maximum, permissible current.
5-3	絶縁抵抗 / Insulation Resistance	IEC : 60512-3-1	DC100V , 60±5sec	△ 初期値 : 50MΩ以上 Initial: 50 MΩ MIN.
5-4	インピーダンス / Impedance		△ 立ち上がり時間 140psec (10-90%)でインピーダンス整合した基板にて差動伝送信号を入力して測定する。 Rise time : 140psec (10-90%) Differential measurement specimen environment impedance: 100Ω differential. Source-side receptacle connector mounted on a controlled impedance PCB fixture	差動伝送方式 : 100±20 Ω Differential Signaling : 100±20 Ω

6. 機械的特性/ Functional performance

No.	項目 / Items	方法 / method	条件 / conditions	規格 / specifications
6-1	コンタクトの保持力 / Contact retention force	IEC : 60512-16-20	25mm/min	△ 0.8N MIN.
6-2	結合力及び離脱力 / Engaging and separating forces	IEC : 60512-13-1	25mm/min	初期値にて / Initial (単極にて) △ 挿入力/ Insertion force : 1.0 N MAX. /Pin 抜去力/ Extraction force: 0.03 N MIN. /Pin
6-3	挿抜耐久性 (繰返し動作) / Insertion/extraction Endurance	JIS : C5402(6.3)	繰返し動作回数 /Operation frequency :30 times	△ 5-1, 9-1
6-4	振動試験 / Vibration test		△ 振動周波数 / frequency :10 ~ 55Hz 振幅 / Amplitude :1.5mm スイープ時間 / sweep time :1 minute 方向 / direction : X, Y, Z 2h	試験中の瞬断 / Discontinuity : ≤ 1 μs △ 5-1, 9-1
6-5	衝撃試験 / Shock test	IEC : C60068-2-27	△ 加速度 / acceleration :490m / s <sup>2</sup> 作用時間 / time :11ms 方向 / Direction :X, Y, Z 3 times	試験中の瞬断 / Discontinuity : ≤ 1 μsec △ 5-1, 9-1

7. 耐候性試験 / weatherability test

No.	項目 / Items	方法 / method	条件 / conditions	規格 / specifications
7-1	高温試験 / Dry heat resistance	IEC:60068-2-2	温度 / temperature : 125±2℃ 時間 / time : 96 h	△ 5-1, 9-1
7-2	耐寒性試験 / Cold resistance	JIS C 60068-2-1	△ 温度 / temperature : -40±3 ℃ 時間 / time : 96 h	△ 5-1, 9-1
7-3	高温高湿試験 / Dump heat steady state	IEC:68-2-3	△ 湿度 / Humidity : 90%RH 温度 / Temperature : 60±2℃ 時間 / Time : 96h	△ 5-1, 9-1
7-4	塩水噴霧試験 / Salt mist	IEC : 68-2-11	水温 / Temperature :35±2℃ 濃度 / Percentage humidity :5±1% 時間 / Time :48h	△ 5-1, 9-1
7-5	SO <sub>2</sub> ガス試験 / SO <sub>2</sub> gas test	JIS C 60068-2-60 JIS C 60068-2-42 JIS C 60068-2-43	温度 / Temperature :40±2℃ 相対湿度 / Percentage humidity :75% RH 濃度 / Cardinality :10±3ppm 時間 / Time :96h	△ 5-1, 9-1
7-6	H <sub>2</sub> S ガス試験 / H <sub>2</sub> S gas test	JIS C 60068-2-60 JIS C 60068-2-42 JIS C 60068-2-43	温度 / Temperature :40±2℃ 相対湿度 / Percentage humidity :75% RH 濃度 / Cardinality :3±1ppm 時間 / Time :96h	△ 5-1, 9-1

No.	項目 / Items	方法 / method	条件 / conditions	規格 / specifications
△ 7-7	熱衝撃試験 / Thermal shock test	JIS C0025	温度 / Temperature : -40~+85℃ サイクル数 / Cycle : 10 cycle (1 サイクル / 1cycle : 1h)	△ 5-1, 9-1
△ 7-8	温湿度サイクル試/ Humidity Resistance (cycling)	JIS C 600682-38	温度 / Temperature : 上限 / Upper +80℃ 下限 / Lower -20℃ 湿度 / Humidity : 90~95% サイクル数 /Cycle :10cycle (1 サイクル /1cycle :8h)	△ 5-1, 9-1

8. その他特性 / Other Performance

No.	項目 / Items	方法 / method	条件 / conditions	規格 / specifications
8-1	はんだ付け試験法 (平衡法) / Solderability test (wetting balance method)		△ 使用はんだ/Solder : Sn-3.0Ag-0.5Cu 温度/Temperature : 245℃±5℃	はんだ付着面積 / Soldering area ≥95%
8-2	半田耐熱性 / Resistance to Soldering heat		① 手半田/Manual soldering 半田鋳温度 /Temperature : 350℃±5℃. 時間 /Time : 3s±0.5sec 回数/Times :1回 /once △ ② リフロー /Reflow-Soldering 温度 /temperature : 下記条件 /see below chart 時間 / time : 下記条件 /see below chart 回数 / times : 2回 ・温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface ・フラックスについては IRISO 選定品使用 / IRISO selection goods use of flux.	5-1, 9-1

8-2-②. リフロー温度条件 /Reflow temperature

プロファイル条件 / Profile Feature	鉛フリーリフロー温度条件 / Reflow temperature of Pb free solder	
予備熱 /Pre-heat		
予備加熱最低温度 / TSmin	: 150℃ MIN.	
予備加熱最高温度 / TSmax	: 180℃ MAX. △	
予備加熱時間 / time( TSmin. to TSmax.)	: 120 sec △	
tL はんだ付け温度 / temperature	: 230℃ MIN. △	
はんだ付け時間 / time	: 40 sec MIN. △	
Tp (ピーク / Peak) ピーク温度 / temperature	: 250℃ MAX. △	

9. 外観 / Appearance

No.	項目 / Items	方法 / method	条件 / conditions	規格 / specifications
9-1	外観 / Appearance	IEC-512-2		有害となる割れ、剥がれ、ガタ変形、変色等のない事。 Should not have any flaw, scratch, Discoloration and crushed.

10. 製品の保管期間

△ 製造日より1年とする。

10. Term of a guarantee

△ 1 year from production day.

11. 保管条件

温度 : -10 ~ +40℃

湿度 : 75%RH以下 ( 相対湿度 )

11. Storage

Temperature range : -10 ~ +40℃

Humidity range : 75%RH or below

12. 使用上の注意

嵌合について

- ・斜め嵌合やこじめる事の無い様に真っ直ぐにゆっくりと挿抜して下さい。
- ・嵌合可能角度は下図の通りになりますので、記載角度以下で嵌合をして下さい。  
嵌合可能角度とは、コネクタの誘い込みによって無理なく嵌合が開始出来る角度 (最初の位置決め) であり、角度を維持した状態での嵌合を保証する角度ではありませんので、あくまで嵌合の際は真っ直ぐに嵌合して下さい。
- ・ズれた状態で基板/ソケットの両者を固定して嵌合しますと、コネクタが破損する可能性がありますので、嵌合の際はどちらかにガタがある状態で、ならい込みによりセンターに嵌合出来る様、配慮をお願い致します。

接続方法について

- ・コネクタのみで基板の固定は行なわないで下さい。
- ・コネクタの実装位置に近い位置で、必ず基板をビスにて確実に固定して下さい。
- ・コネクタにかかる加速度は、セット組立品に於いても 43.12m/s<sup>2</sup> 以下として下さい。  
(共振振動が加わらない事)。

△

13. 和文と英文の差異について

和文と英文の内容に差異が生じた場合には、和文の内容を優先致します。

12. Attention of using connector

Mating of connector

- ・ When the connector is mating, connector shall not be twisted, and then mated it slowly.
- ・ You may mate connectors within the angle written in the pictures below.  
The possible mating angle is the angle that you can begin mating connectors easily by using a guide.  
However, it doesn't guarantee that you can mate them keeping the angle.  
So please make sure you mate straightly.
- ・ If you mate the socket and PCB out of alignment, they can be broken.  
So please mate with a gap on either side, using a guide.

Connect of connector

- ・ It shall not be held the connector only, when you are assembled for the connector and P.C.B.
- ・ When it shall be used the connector, the P.C.B. are held by the rivet certainty near mounting of the connector.
- ・ Acceleration of connector : 43.12m/s<sup>2</sup> or less.  
(The connector shall not be added to be added to resonance acceleration.)

△

13. Difference between Japanese and English

When difference is found between Japanese Specifications and English Specifications, priority shall be given to Japanese.

# B to B コネクタ

## Board to Board Connector

# 取り扱い説明書

## Manual

適用製品 : 11007 シリーズ

0.4mm ピッチ B to B コネクタ

Application product : 11007 series

0.4mm pitch Board to Board Connector

《取り扱い方法》 Handling method

嵌合について / Mating of connector

- ・斜め嵌合やこじる事の無い様に真っ直ぐにゆっくりと挿抜して下さい。  
When the connector is mating, connector shall not be twisted, and then mated it slowly.
- ・誘い込み時の角度は図 1～図 2 になりますので、記載角度以下で位置決めをして下さい。  
Figure 1 and 2 show guiding angle. Please locate it below the described angle.  
(誘い込み時の角度とは最初の位置決め角度であり、嵌合可能な角度ではありません。)  
(Guiding angle is initial location angle. It is not the angle to mate.)
- ・位置決め後、モールドどうしがゆるく嵌まるまで嵌合して下さい。  
After locate, please mate connector where the molds fit loosely.
- ・嵌合時の許容角度は図 3～図 4 になりますので、記載角度以下で使用してください。  
Please mate it below the angle of the figure 3, 4.
- ・下図のモデル形状は参考とします (現物と異なる場合があります)  
It refers to a fig. (It differs from a actual connector.)

誘い込み時の角度 / Guiding angle

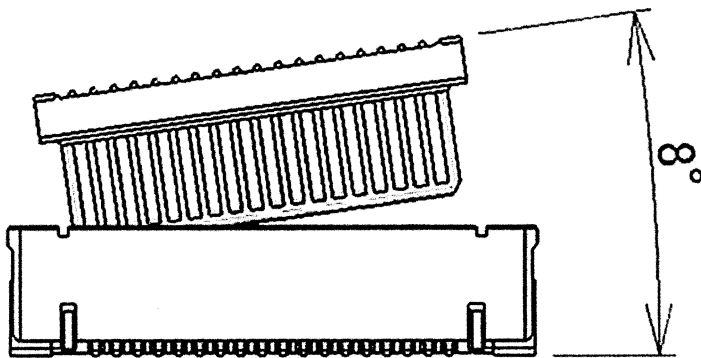


Fig.1

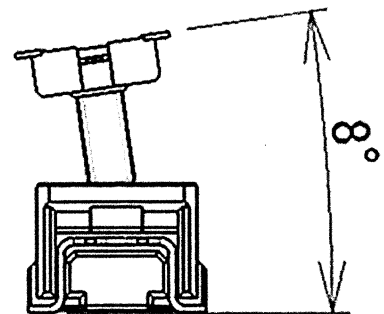


Fig.2

嵌合角度 / Mating angle

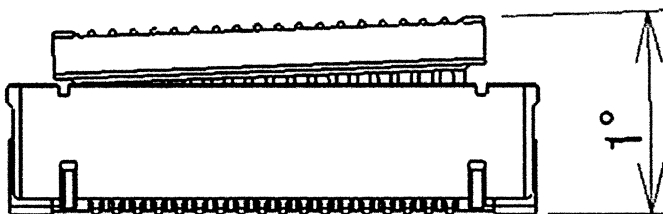


Fig.3

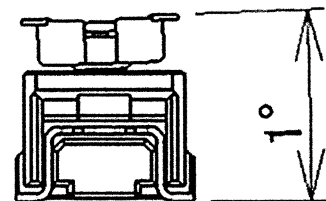


Fig.4